

Wellsenn XR



AI眼镜拆解及BOM成本报告

理想 Livis AI眼镜

Wellsenn

理想 Livis AI眼镜是理想汽车推出的首款 AI 智能穿戴设备，搭载恒玄 BES2800BP 蓝牙音频 SOC 和研极微 ISP 芯片，主打轻量化佩戴、深度车控互联和全天候 AI 助理。作为消费级市场热销产品，理想 Livis AI眼镜的硬件架构与技术选型对行业技术迭代与产品落地具有重要参考价值。本报告以理想 Livis AI眼镜为拆解对象，从多维度出发，针对硬件拆解、逻辑解析、结构透视、供应链溯源以及成本构成等方面分析，为AI眼镜产业从业者、技术研究者、相关领域参与者以及爱好者提供兼具深度与实用性的参考资料。

硬件层面，本报告对设备核心部件进行精细化解构，涵盖主板芯片、传感器、结构件、散热模组、声学模组以及充电盒等重要组件，对其中的作用原理、协作逻辑深度解析，清晰展示各部件的技术特性与装配逻辑。

供应链层面，本报告梳理了理想 Livis AI眼镜核心组件供应商，明确歌尔、恒玄、研极微、舜宇、索尼、豪鹏、佰维等国内外供应链厂商角色，解析AI眼镜产业全球化协作与国产化供应商渗透的生态格局。

成本层面，根据维深 wellsenn XR 的拆解及当前时点的市场行情调研统计（注：因存储市场价格变化过大，本报告存储成本以去年 10 月份的备货节点计算），理想 Livis AI眼镜的 BOM 成本约 122.59 美元，综合硬件成本 104.59 美元，按美元汇率 7.0，增值税 13% 计算，理想 Livis AI眼镜的税后成本约 969.69 元（不含 NRE 费、开模费、不良和运损等）。

本报告会员完整版共 47 页，对理想 Livis AI眼镜进行了系统、全面的拆解分析，针对核心芯片、摄像头模组、音频模组、精密结构件、充电盒等重要部件，进行原理作用、成本结构等分析，最终基于各项数据整理。完整版报告请付费购买或加入维深会员查看。

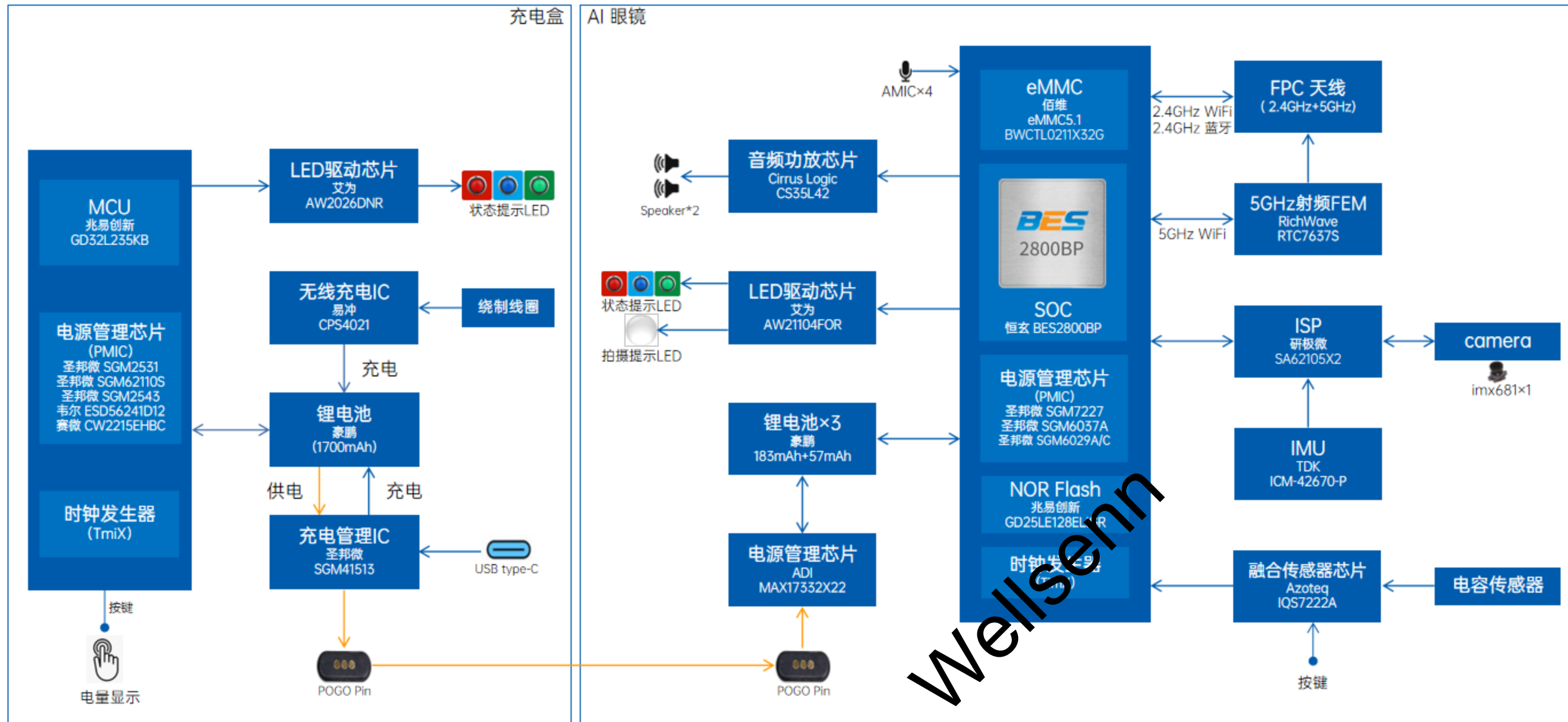
一、理想 Livis AI眼镜参数配置	4
二、理想 Livis AI眼镜及充电盒逻辑框图	5
三、理想 Livis AI眼镜主板分析	
(1) 主板-正面芯片信息	6
(2) 主板-背面芯片信息	9
(3) 主板-BOM清单表	13
四、理想 Livis AI眼镜拆解：镜框	14
五、理想 Livis AI眼镜拆解：镜框FPC	15
六、理想 Livis AI眼镜拆解：左镜腿	17
七、理想 Livis AI眼镜拆解：左镜腿结构件	18
八、理想 Livis AI眼镜拆解：右镜腿	20
九、理想 Livis AI眼镜拆解：右镜腿结构件	21
十、理想 Livis AI眼镜拆解：转轴	22
十一、理想 Livis AI眼镜拆解：麦克风与扬声器	23
十二、理想 Livis AI眼镜拆解：扬声器 X 光透视图	24
十三、理想 Livis AI眼镜拆解：频响曲线对比	26
十四、理想 Livis AI眼镜拆解：摄像头与IMU	27
十五、理想 Livis AI眼镜拆解：摄像头 X 光透视图	28
十六、理想 Livis AI眼镜拆解：眼镜 X 光透视图	29
十七、理想 Livis AI眼镜拆解：眼镜BOM（除主板外）	31
十八、理想 Livis AI眼镜拆解：充电盒	32
十九、理想 Livis AI眼镜拆解：充电盒结构件	33
二十、理想 Livis AI眼镜拆解：充电盒主板	36
二十一、理想 Livis AI眼镜拆解：充电盒BOM	41
二十二、理想 Livis AI眼镜综合成本	42
二十三、理想 Livis AI眼镜综合成本构成	43
二十四、理想 Livis AI眼镜拆解部件重量示意图	45
二十五、理想 Livis AI眼镜综合重量构成	46

Wellsenn

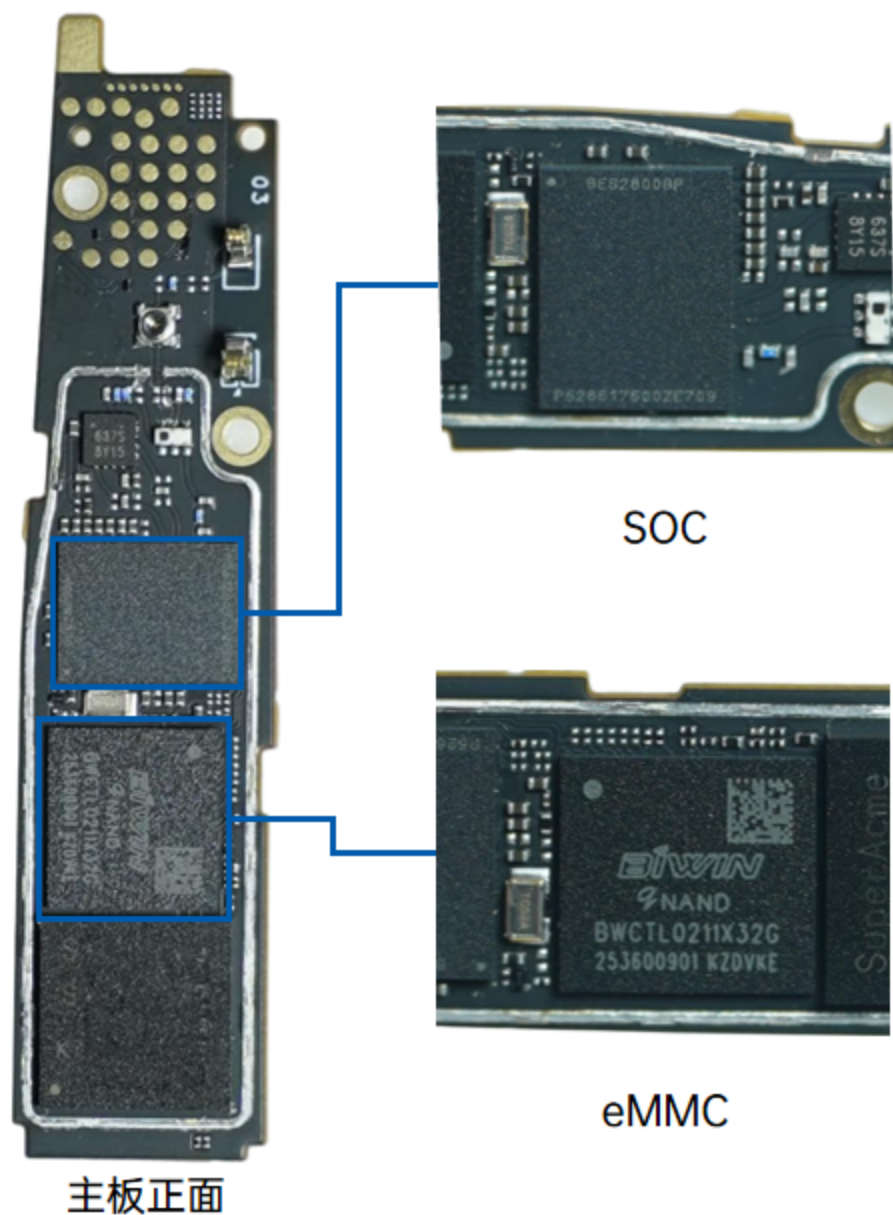
计算平台	SOC	恒玄 BES2800BP
	存储	32GB
	WiFi	WiFi 6
	蓝牙	蓝牙 5.4, 双模
	交互应用	理想同学 App
光学	镜片	蔡司镜片
	近视调节	支持官方定制近视镜片
传感器	IMU	六轴 IMU, 配合摄像头实现视频 EIS 防抖
	接近传感器	电容传感器, 支持人脸佩戴感应
	环境光传感器	检测环境光线强度, 防止隐私提示灯被遮挡
摄像头	传感器	IMX 681
	镜头	1G+4P 超透光学镜头, F2.2 大光圈, 105° FOV 超广角
	ISP	研极微
	算法	黑芝麻智能
交互	触摸	单镜腿触摸, 支持单击、双击、三击、长按、滑动等操作
	按键	记录按键
	语音	支持语音交互
设计	重量	36.6g
	尺寸	镜框尺寸 55□18 147, 镜框面宽 137mm
电源	防水认证	IP54
	电池容量	240mAh
声学	麦克风	四麦克风阵列
	扬声器	双磁路三明治扬声器
指示灯	隐私提示灯	白色LED灯, 提示拍摄状态
	状态提示灯	三色LED灯, 提示电源、配对等状态
充电盒	LED灯	三色LED等, 提示开合、充电等状态
	按键	查看充电盒电源状态
	电池容量	1700mAh
	重量	130.0g

Wellsenn

理想 Livis AI眼镜逻辑框图



资料来源: wellsenn XR制图



● 恒玄 BES2800BP

恒玄低功耗、高性能智能穿戴 SOC BES2800，该芯片集成双核 Arm Cortex-M55 处理器和双核 BECO NPU 组成的 CPU 主系统，双核 STAR-MC1 处理器和双核 BECO NPU 组成的子系统，集成 BES 专有协处理器，用于高级信号处理和网络工作负载；集成双模蓝牙 5.4 系统，兼容蓝牙经典和 LE 音频，同时也作为高通量无线连接的 Wi-Fi 6 系统；集成音频编解码系统，包含 1 路 DAC、3 路 ADCs，支持 EQ 调节与重采样功能；集成多媒体系统，包含一个 2.5D GPU，支持最高 3 层 Alpha 的液晶控制器混合功能，以及 4 通道或双 2 通道的 MIPI DSI，最高支持 720p 24bpp 分辨率。集成 8.3MB SRAM。采用 363-pin BGA 封装。

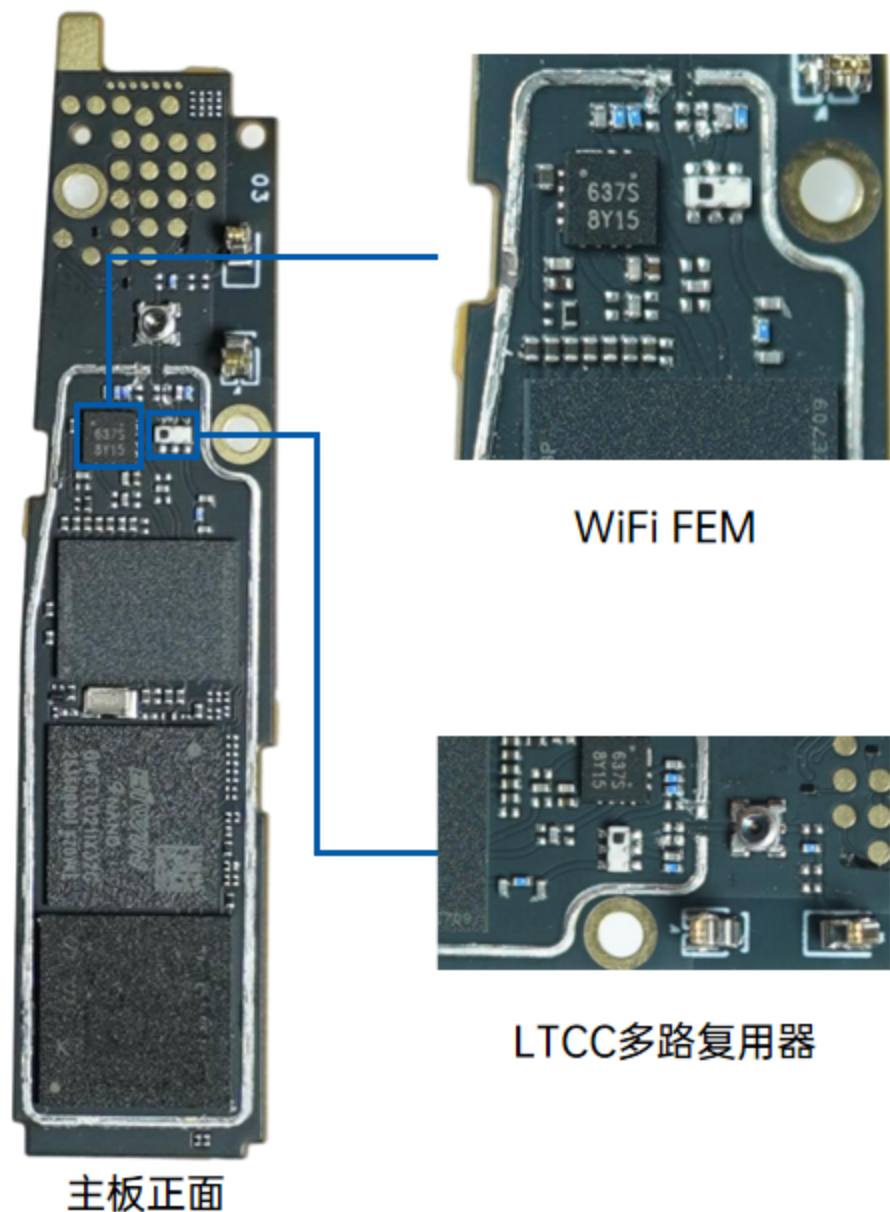
在理想 Livis AI 眼镜中，恒玄 BES2800BP 作为 AI 眼镜的控制中枢，主要用于支持底层系统的运行，执行指令以及逻辑运算，实现无线通信连接、音频播放等功能。

● 佰维 BWCTL0211X32G

佰维 eMMC 存储器，型号 BWCTL0211X32G，容量 32GB，支持 eMMC 5.0 & eMMC 5.1 接口，最大顺序读取速度 320MB/s，最大顺序写入速度 260MB/s，工作电压 VCC=3.3V，VCCQ=1.8V，工作温度 -20°C~85°C，采用 FBGA 封装。

eMMC 是一种高集成度的嵌入式非易失性存储解决方案，集成 NAND Flash 阵列、闪存控制器和标准 eMMC 接口。闪存控制器负责管理 NAND Flash 阵列的复杂操作，包括 ECC 错误校验与纠错、磨损均衡、坏块处理、垃圾回收、地址映射等功能，主机 CPU 可直接通过标准接口读写，大幅减少了主机 CPU 存储管理负担，降低开发难度与成本。

在理想 Livis AI 眼镜中，佰维 eMMC 存储芯片主要用于存储系统文件、用户数据等。



● RichWave RTC7637S

立积电子 (RichWave) 5GHz 射频前端芯片 RTC7637S, 丝印 637S 8Y15。该芯片设计用于 802.11a/n/ac WLAN 应用, 内置发射/接收链路。集成带功率检测的功率放大器 (PA)、用于谐波抑制的低通滤波器 (LPF)、T/R 开关及接收低噪声放大器 (LNA)。发射路径下, 典型增益 27dB, 802.11ac HT80/MCS9 波形下以 -35dB DEVM 提供 16dBm 线性输出功率; 接收路径下, 提供 13dB 高增益和 2.6dB 低噪声系数。采用 QFN 封装, 封装尺寸 2.3mm x 2.3mm x 0.4mm。

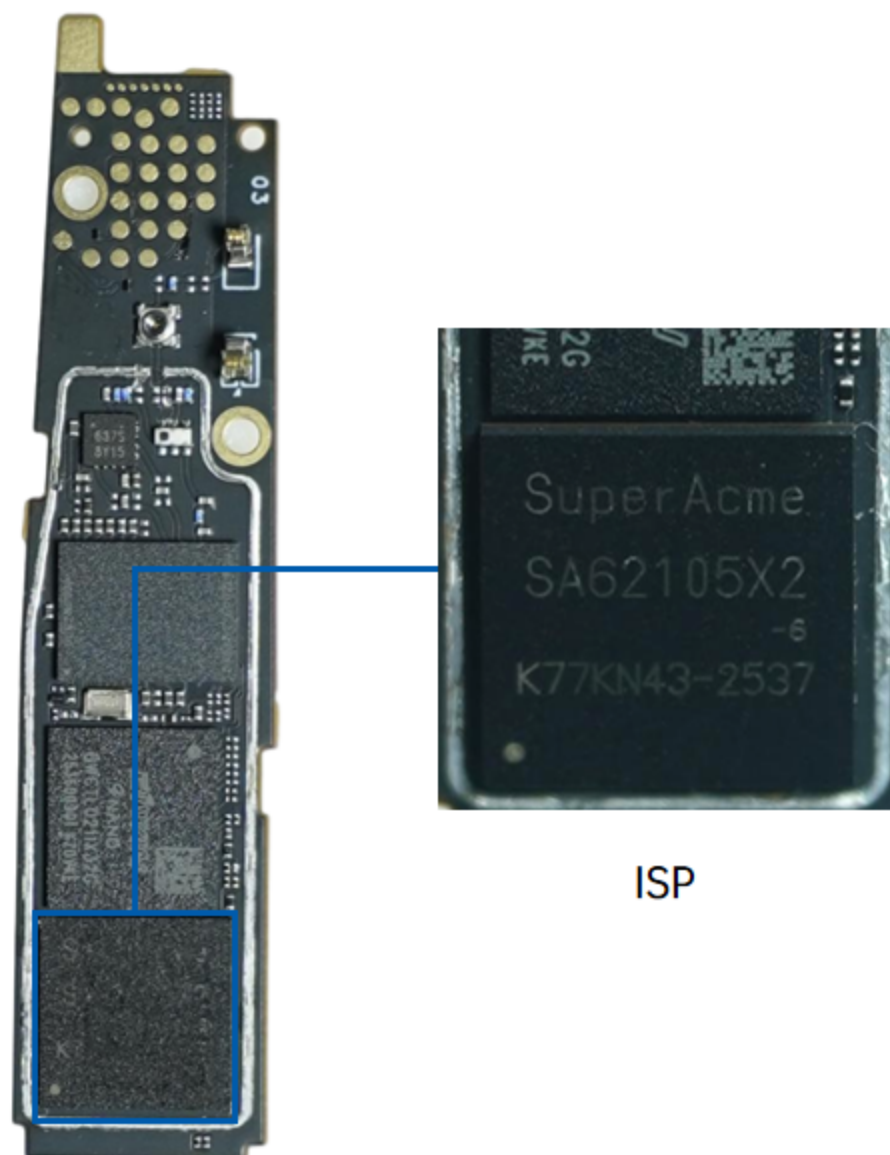
在理想 Livis AI眼镜中, 主要用于 WiFi 信号功率放大, 实现数据收发。

● 射频 LTCC 多路复用器

LTCC多路复用器, 用于多路信号 (2.4GHz 蓝牙/2.4GHz WiFi + 5GHz WiFi) 的合路发射和分路接收, 隔离两个不同频段, 避免互相干扰, 实现单天线承载两个不同频段信号的收发, 实现天线共用。

理想 Livis AI眼镜 2.4GHz 射频链路: FPC 天线 (金属弹片处) → 复用器 → 恒玄 BES2800BP;

理想 Livis AI眼镜 5GHz 射频链路: FPC 天线 (金属弹片处) → 双工器 → 5GHz FEM → 恒玄 BES2800BP。



ISP

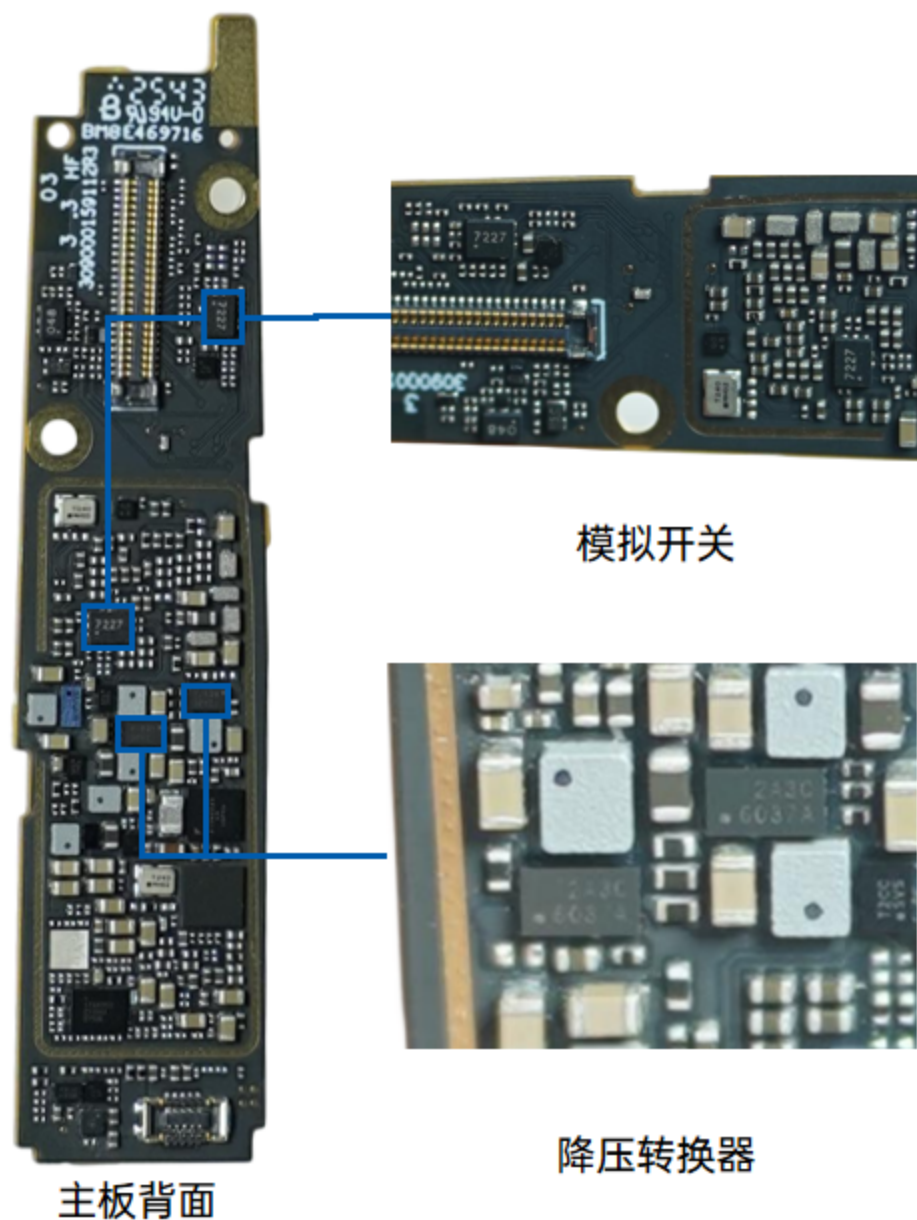
主板正面

● 研极微 SA62105X2

研极微的低功耗智能影像芯片 SA62105X2，内置 256MB LPDDR4，集成双核 ARM Cortex A55@1.2GHz + Arm Star MCU@600MHz CPU，L2 缓存 128KB，L3缓存 512KB；集成自研 Heron NPU，支持 2Tops@INT8 / 8Tops@INT4 算力，提供人脸、人形、车辆、宠物等多种算法，支持 PyTorch、ONNX、Caffe 和 TensorFlow 等标准框架，支持 VVNE/ANNE 视觉/语音加速引擎；集成 AI ISP，支持 0.05Lux 黑光全彩、5M@30fps HDR 处理、多级降噪与 6DoF 电子防抖，集成 FPN/BLC/LDC/DPC/3A 等算法，支持第三方 3A 算法可调；集成 H.264/H.265 VPU，最大支持 5M@30fps 编码；集成 JPEG编解码，最大支持 12MP 编解码；支持 eMMC5.0、SDIO3.0、USB2.0 OTG 高速接口；支持 192kHz 音频采样、4 路数字麦克风输入，搭载音频 3A、语音唤醒、背景噪声消除与声源定位算法；集成 16Kbit OTP 存储，支持 TrustZone 安全隔离、AES/RSA/HASH 硬件加密校验；典型功耗 300mW (4M15+1Tops)；采用 FC-BGA 8.5mmx8.5mm 封装。

在理想 Livis AI眼镜中，该芯片主要用于摄像头图像信号处理、视频/照片编解码以及本地 AI 视觉感知。

Wellsenn



模拟开关

降压转换器

主板背面

● 圣邦微 SGM7227YUWQ10G/TR

圣邦微双极/双掷 (DPDT) 模拟开关，丝印 7227。该芯片用于高速信号切换，兼具低功耗、高隔离、宽电压供电特性。每个开关都是双向的，可确保高速信号在输出端几乎没有或没有衰减。单电源供电电压 1.8V~4.3V，3.0V 供电时导通电阻 5Ω，全温区最大 9Ω，高速信号衰减可忽略；3.3V 下，典型开启时间 20ns、关断时间 18ns，支持 480Mbps USB 2.0 高速信号无卡顿切换。集成电源关断保护、电源上电过压保护、D+/D- 引脚 VBUS 短路保护，防止意外信号泄露，并确保断电和过压条件下的系统可靠性。工作温度 -40°C~85°C，采用 UTQFN-1.8×1.4-10L 封装。

在理想 Livis AI眼镜中，该芯片主要用于电源、数据或调试复用等高速信号路由切换。

● 圣邦微 SGM6037A

圣邦微同步降压转换器 SGM6037A，丝印 T2A3C 6037A。该芯片支持在 2.4V~5.5V 输入电压范围内提供 4A 的输出电流。典型静态电流 5μA，关断模式下 0.1μA。轻载时自动进入 PFM 省电模式，提升轻载效率，中重载时切换至 CCM 模式，固定 2.3MHz 开关频率，减少 EMI 干扰。支持 I²C 编程强制 PWM (fPWM) 模式，实现全负载范围低输出纹波。该芯片采用恒定导通时间 (COT) 架构，具备快速负载和线路瞬态响应以及低输出电压纹波的特性。电压输出范围 0.4V~1.15V。集成热警告/热关断、过流打嗝保护、欠压锁定、输出放电等功能。工作温度 -40°C~125°C，采用 WLCSP-1.05×1.78-15B 封装。

在理想 Livis AI眼镜中，该芯片主要用于动态调节电压，满足不同组件的负载需求。



主板背面



降压转换器



- SGMICRO SGM6029A/SGM6029C

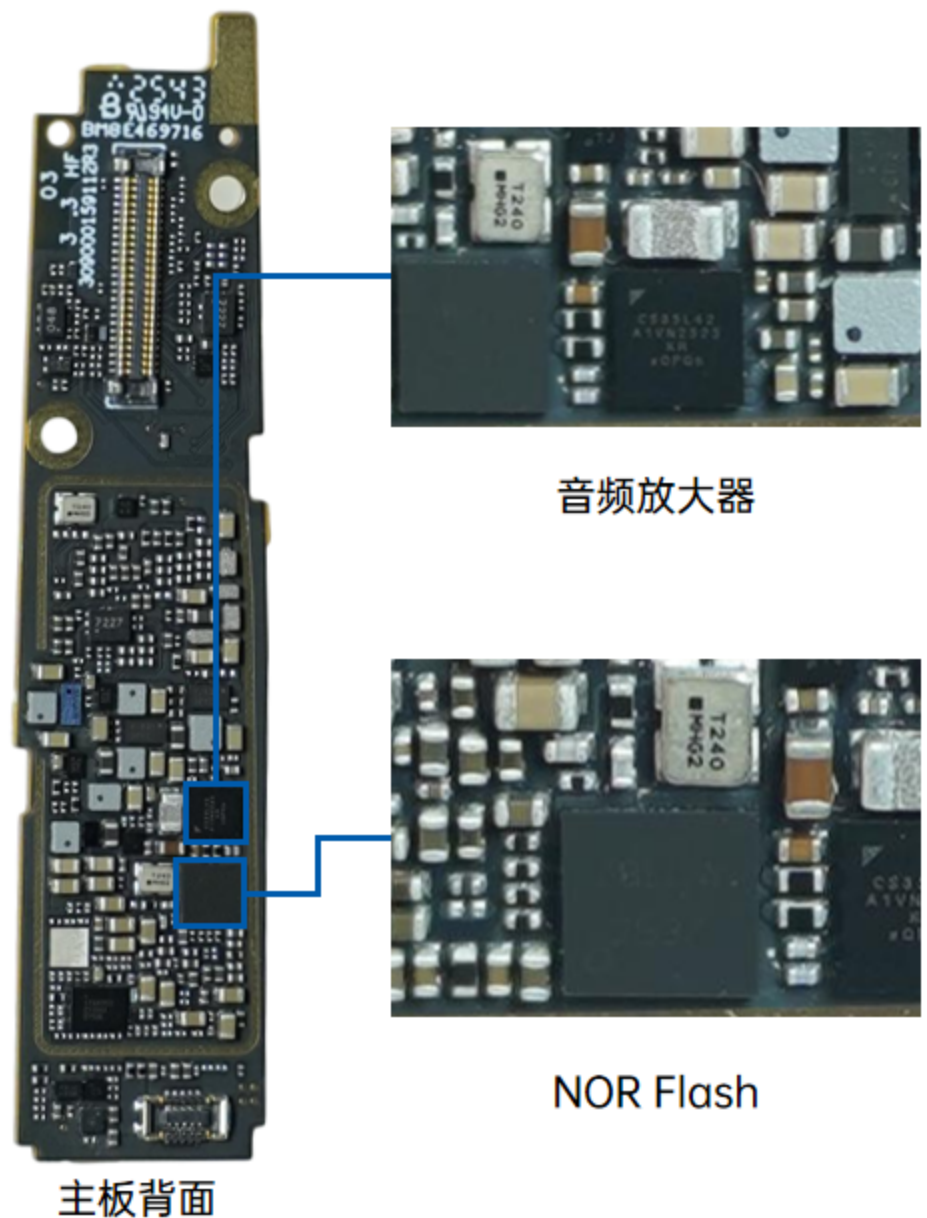
圣邦微同步降压转换器 SGM6029C 和 SGM6029A，丝印分别为 T2CC SVS 和 T2AC SVQ。该芯片输入电压 1.95V~5.5V，支持自动 PFM/PWM 模式切换，集成 R2D (电阻转数字) 转换器实现电压编程。采用恒定导通时间 (COT) 架构，兼具快速瞬态响应 (负载突变时电压恢复快) 和低输出纹波特性。轻载自动进入 PFM 省电模式，静态电流 2.3 μ A (TYP)。中重载下自动切换至 PWM 模式，固定 4.0MHz 开关频率，支持通过 VSEL/MODE 引脚强制 PWM 模式。集成输出放电、过流限制、热关断、欠压锁定等功能。两颗芯片区别在于输出电压范围、步进精度和默认电压。SGM6029C 输出电压范围 1.8V~3.3V，支持 16 档可编程 100mV 步进精度，适用于无线模块、内存等中压中电流场景；SGM6029A 输出电压范围 0.4V~0.775V，支持 16 档可编程 25mV 步进精度，适用于传感器、低功耗芯片外围等场景。工作温度 -40 $^{\circ}$ C~85 $^{\circ}$ C，采用 WLCSP-0.74 \times 1.09-6B。

在理想 Livis AI眼镜中，该芯片主要用于动态调节电压，满足不同组件的电压需求。

- 未知芯片

丝印 4506 CF25S。

Wellsenn



● Cirrus Logic CS35L42

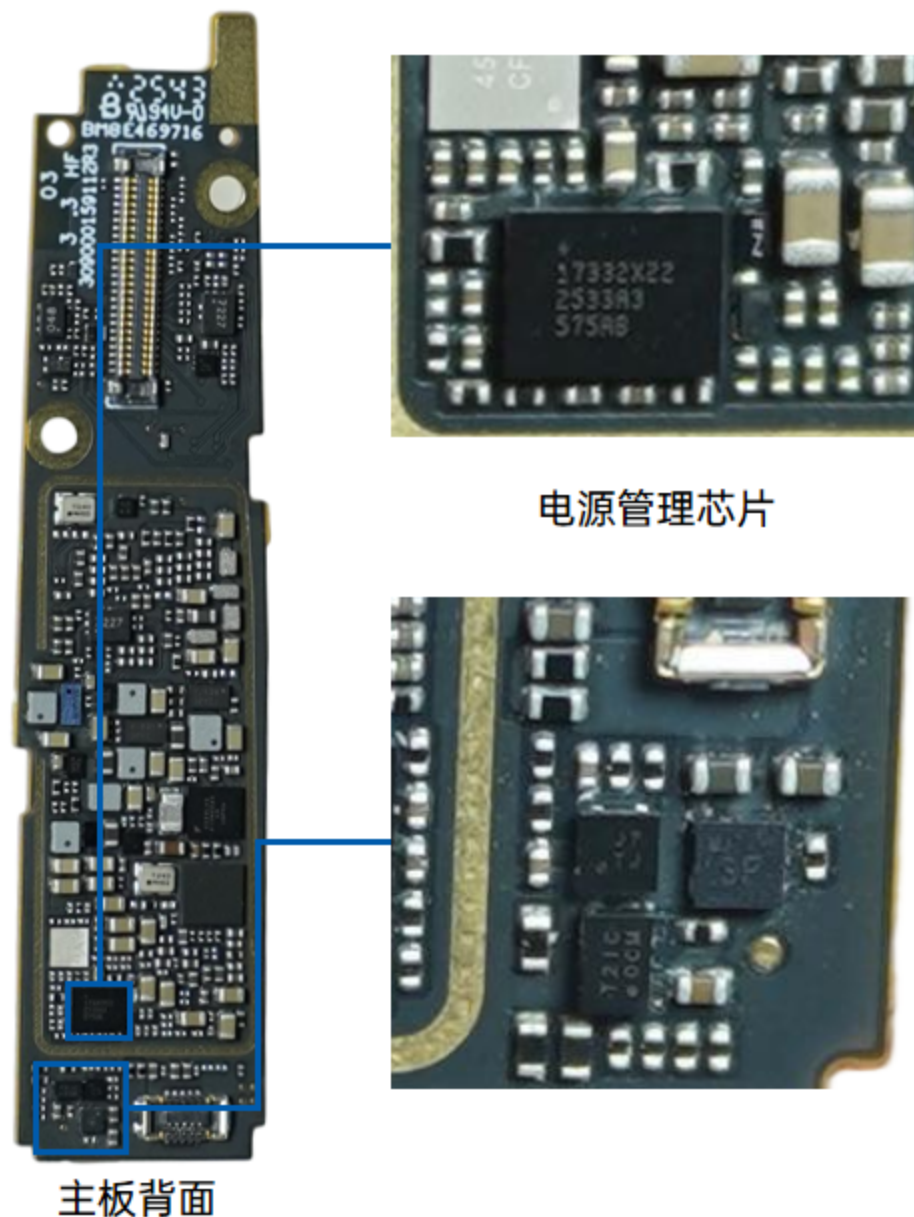
Cirrus Logic D 类放大器 CS35L42，该芯片集成单声道音频放大器、数字升压转换器与 130 MCPS Halo Core™ DPS 模块，通过片内 DSP 分担应用处理器的音频工作，降低系统整体功耗。支持 44.1~96 kHz 采样率。D 类功放采用 $\Delta\Sigma$ 闭环架构，支持 I2S/TDM 串行数字音频输入，可编程数字音量和功放增益。数字升压转换器采用 Class H 包络跟踪升压电源，集成升压和整流 FET，2MHz 开关频率，最高升压至 11V。DSP 承担音频路径的均衡、增强、扬声器保护全流程处理，提供灵活的调音能力。芯片集成过温关断保护、短路保护、欠压保护、扬声器保护等。工作温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ ，采用 WLCSP-2.28×2.46×0.49-30-B 封装。

在理想 Livis AI眼镜中，该芯片主要用于驱动扬声器，实现音频功放功能。

● 兆易创新 GD25LE128ELIGR

兆易创新 NOR Flash 芯片 GD25LE128ELIGR，丝印 Z8ELW 2537，容量 16MB，支持标准 SPI、双 SPI、四 SPI 和 QPI 模式，最高数据传输速率 532Mbits/s，支持最少 10 万次擦写循环和 20 年数据保留期，支持 XiP 操作以降低指令获取延迟。支持软/硬件写保护、128 位唯一设备 ID 以及 3 个 1024 字节 OTP 安全寄存器。采用 1.65~2.0V 单电源供电，典型待机电流 11 μA ，深度掉电电流 0.20 μA ，工作温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ ，采用 WLCSP 4-4 16 球阵列封装，封装尺寸 2.8mm×2.8mm×0.3mm。

在理想 Livis AI眼镜中，该芯片主要用于存储固件代码、配置文件、设备标识、配对信息等系统初始化数据。



电源管理芯片

主板背面

- Analog Devices MAX17332X22

亚德诺半导体 电源管理芯片 MAX17332X22，该芯片集成充电控制模块、电池电量计、保护器以及电池内部自放电检测功能，采用 Maxim 专利的 ModelGauge m5 EZ 算法，无需主机干预即可实现电池管理，简化电池管理系统设计，降低 PCB 面积和系统成本。充电控制模块采用 AccuCharge™ 充电技术，支持恒流、恒压、恒功率、温度限制调节等多模式充电，适配 JEITA 温度曲线和阶梯充电策略；电量计模块融合库仑计数器的短期精度与电压型电量计的长期稳定性，自动学习电池容量和特性，无需手动校准。保护器提供可编程保护，覆盖电压、电流、温度、时序等多维度故障。工作温度 -40°C~85°C，采用 1.9mm×2.5mm 15-Bump WLP 封装。

在理想 Livis AI眼镜中，该芯片主要用于眼镜右镜腿电池的充电管理与电量监控。

- 未知芯片

丝印 T2IC OCM

丝印 J7 TJ

丝印 3P

Wellsenn



*该部分为付费内容，感兴趣可添加 wellsenn XR助手微信购买付费版本

个人版
9999 RMB

企业版
12999 RMB

海外版
4999 USD

会员
免费

发布日期
2026年3月



维深信息 wellsenn XR 助手
微信: 17302629715
添加请备注: 商务合作/购买付费版报告

2024年，维深信息开始推出免费版和付费版两个版本的报告，付费版本将在过往报告的基础上，新增更翔实的数据、更深度的分析，特别是器件参数、销量数据、成本价格等等，付费报告将凝结维深信息团队的大量一手调研信息和专业知识积累，比免费版包含更多的信息量与参考价值，能为XR相关企业的战略研究、产品经理、金融机构的投资分析等部门提供更好的决策参考依据。

【关于付费】

付费版报告可以单独购买，也可以通过加入会员的方式阅读付费报告。会员在有效期间获得该期间维深信息发布的所有付费报告，每年约25至40篇，性价比更高。会员费用为99999元/年，更多会员服务欢迎扫码添加微信咨询，微信号：wellsenn001。

【报告体系】



【数据库】

公司目前共建有两个数据库，包括VR/AR/AI眼镜出货量数据库、XR内容数据库，数据来源于线下调研、供应链调研、网络爬取等，并经过多重交叉验证。

序列	发布时间	报告类型	报告名称	页数	免费/会员
76	2026年4月16日	AI眼镜拆解	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：理想 Livis AI眼镜》	47	会员
75	2026年3月31日	AI眼镜用户调研	《夸克AI眼镜S1用户体验调研报告》	93	会员
74	2026年3月24日	XR/AI眼镜销量跟踪报告	《VR/AR产业2025年度销量跟踪报告》	43	会员
73	2026年3月19日	AI眼镜拆解报告	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：Oakley Meta Vanguard AI眼镜》	42	会员
72	2026年2月9日	AI眼镜拆解报告	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：Rokid Glasses AR眼镜》	41	会员
71	2026年1月31日	XR/AI眼镜销量跟踪报告	《2025年第4季度VR/AR/AI眼镜产业销量跟踪报告》	26	会员

Wellsenn

序列	发布时间	报告类型	报告名称	页数	免费/会员
70	2026年1月21日	XR硬件拆解报告	《无人机拆解及BOM成本报告：影翎 Antigravity A1 标准套装》	64	会员
69	2025年12月30日	AI眼镜调研专题报告	《Rokid Glasses用户体验调研报告》	93	会员
68	2025年12月29日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Meta Display AR眼镜》	91	会员
67	2025年12月18日	AI眼镜拆解报告	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：夸克S1 AI+AR眼镜》	55	会员
66	2025年12月8日	AI眼镜调研专题报告	《MIJIA智能音频眼镜2用户体验调研报告》	66	会员
65	2025年11月1日	XR/AI眼镜销量跟踪报告	《2025年第3季度VR/AR/AI眼镜产业销量跟踪报告》	24	会员
64	2025年10月24日	AI眼镜拆解报告	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：Oakley Meta HSTN AI眼镜》	38	会员
63	2025年9月15日	AI眼镜调研专题报告	《小米AI眼镜用户体验调研报告系列二：电商平台用户评价》	25	会员
62	2025年9月1日	AI眼镜调研专题报告	《大学生AI眼镜消费倾向报告：产品认知、购买倾向与消费选择》	43	会员
61	2025年8月22日	AI眼镜拆解报告	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：华强北全志V62方案AI眼镜》	26	免费
60	2025年8月7日	AI眼镜调研专题报告	《小米AI眼镜用户体验调研报告》	80	会员
59	2025年8月4日	AI眼镜拆解报告	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：小米AI眼镜-电致变色 彩色版》	37	会员
58	2025年7月31日	XR/AI眼镜销量跟踪报告	《2025年第2季度VR/AR/AI眼镜产业销量跟踪报告》	24	会员
57	2025年7月18日	AI眼镜拆解报告	《AI眼镜拆解及BOM成本报告：雷鸟 V3 AI拍摄眼镜》	36	会员

序列	发布时间	报告类型	报告名称	页数	免费/会员
56	2025年7月15日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Even G1 AR眼镜》	38	会员
55	2025年6月30日	AI眼镜拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：MIJIA 智能音频眼镜2》	28	会员
54	2025年6月16日	AI眼镜调研专题报告	《中国传统眼镜调研报告系列（二）全国传统眼镜品牌门店分布与区域龙头分析报告》	60	会员
53	2025年5月12日	AI眼镜调研专题报告	《雷鸟V3 AI拍摄眼镜用户体验调研报告》	72	会员
52	2025年5月9日	AI眼镜拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：solos AirGo™ V AI眼镜》	25	会员
51	2025年4月30日	XR/AI眼镜销量跟踪报告	《2025年第1季度VR/AR/AI眼镜产业销量跟踪报告》	24	会员
50	2025年4月22日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2024年度销量跟踪报告》	43	会员
49	2025年4月3日	AI眼镜调研专题报告	《AI智能眼镜电致变色镜片产业研究报告》	36	免费
48	2025年3月6日	AI眼镜调研专题报告	《中国传统眼镜调研报告系列（一）线下眼镜门店分布分析报告》	56	会员
47	2025年2月19日	AI眼镜拆解报告（预测）	《小米AI智能眼镜拆解及BOM成本报告（预测）》	6	免费
46	2025年2月8日	AI眼镜销量跟踪报告	《AI智能眼镜销量跟踪报告--2024年度》	8	免费
45	2025年1月24日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业销售量跟踪系列报告-2024年第四季度》	24	会员
44	2025年1月6日	XR光学研究报告	《AR光学专题研究报告：从离轴透镜到光波导》	91	免费
43	2024年12月25日	AI眼镜调研专题报告	《Ray-Ban Meta 智能眼镜（问卷）调研报告系列四——国内用户体验报告》	51	会员

序列	发布时间	报告类型	报告名称	页数	免费/会员
42	2024年11月18日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Pico 4 Ultra MR一体机》	37	免费
41	2024年11月4日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业销售量跟踪系列报告 2024年第三季度》	19	会员
40	2024年8月29日	AI智能眼镜白皮书	《AI智能眼镜白皮书》	40	免费
39	2024年8月19日	AI眼镜拆解报告	《AI智能眼镜拆解及BOM成本报告：Ray-Ban Stories与Ray-Ban Meta对比拆解》	20	免费
38	2024年8月16日	AI眼镜调研专题报告	《Ray-Ban Meta 智能眼镜调研报告 系列三：TikTok海外平台用户体验报告》	25	会员
37	2024年8月12日	AI智能眼镜产业图谱	《AI智能眼镜产业图谱》	1	免费
36	2024年8月7日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业销售量跟踪系列报告 2024年第二季度》	19	会员
35	2024年7月24日	AI眼镜调研专题报告	《Ray-Ban Meta 智能眼镜调研报告系列二：专业用户体验报告》	28	会员
34	2024年7月15日	AI眼镜调研专题报告	《Ray-Ban Meta 智能眼镜调研报告系列一：用户体验报告》	30	会员
33	2024年6月26日	XR硬件拆解报告	《Apple Vision Pro拆解专项报告——（硅基）Micro OLED》	38	会员
32	2024年6月13日	XR调研专题报告	《全球AR运动眼镜调研报告》	70	会员
31	2024年5月20日	XR硬件拆解报告	《Apple Vision Pro 专项拆解报告：Pancake》	39	会员
30	2024年5月15日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2024年第一季度销量跟踪报告》	19	会员
29	2024年5月9日	XR硬件拆解报告	《Apple Vision Pro专项拆解报告：dToF》	25	会员

序列	发布时间	报告类型	报告名称	页数	免费/会员
28	2024年4月24日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Apple Vision Pro》	105	会员
27	2024年4月8日	XR内容专题报告	《2023年全球VR内容年度分析报告》	57	会员
26	2024年3月26日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2023年度销量跟踪报告》	42	会员
25	2024年3月25日	XR调研专题报告	《2021年~2023年全国VR教育市场调研报告》	107	会员
24	2024年1月29日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2023年第四季度销量跟踪报告》	13	免费
23	2023年12月15日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Ray-Ban Meta 智能眼镜》	31	免费
22	2023年11月16日	XR技术专题报告	《XR显示屏幕系列研究报告——开篇：通往沉浸之路》	32	免费
21	2023年11月8日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Meta Quest 3 MR一体机》	43	免费
20	2023年11月1日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2023年第三季度销量跟踪报告》	13	免费
19	2023年10月27日	XR内容专题报告	《3D内容制作与生成产业研究报告》	54	免费
18	2023年10月20日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Meta Quest 2 VR一体机》	34	免费
17	2023年8月15日	XR内容专题报告	《苹果MR交互方式与内容开发研究报告》	40	免费
16	2023年7月31日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2023年第二季度销量跟踪报告》	12	免费
15	2023年5月31日	XR调研专题报告	《中国消费端VR内容开发商调研报告》	23	免费

序列	发布时间	报告类型	报告名称	页数	免费/会员
14	2023年04月28日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2023年第一季度出货量跟踪报告》	8	免费
13	2023年04月03日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：索尼PS VR2》	34	免费
12	2023年03月17日	XR销量跟踪报告	《2022年度VR/AR产业出货量跟踪报告》	14	免费
11	2023年03月13日	XR内容专题报告	《PICO VR内容平台研究报告》	36	免费
10	2023年02月01日	XR内容专题报告	《Meta Quest 平台2022年内容分析报告》	28	免费
9	2023年01月19日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2022年第四季度出货量跟踪报告》	8	免费
8	2023年01月09日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：华为 Vision Glass 智能观影AR眼镜》	17	免费
7	2022年11月21日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Meta Quest Pro VR一体机》	48	免费
6	2022年10月31日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2022年第三季度出货量跟踪报告》	8	免费
5	2022年10月06日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Pico 4 VR一体机》	36	免费
4	2022年08月23日	XR硬件拆解报告	《XR硬件拆解及BOM成本报告：Pico Neo 3》	31	免费
3	2022年08月02日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2022年第二季度出货量跟踪报告》	10	免费
2	2022年06月06日	XR技术专题报告	《VR光学专题研究报告：从菲涅尔到Pancake》	43	免费
1	2022年04月16日	XR销量跟踪报告	《VR/AR产业2022年第一季度出货量跟踪报告》	15	免费



何万城 Wellsenn XR 首席分析师
电话/微信: 18611823719
Email: hewancheng@wellsenn.com



李浩斌 Wellsenn XR 助理分析师
电话/微信: 15775054184
Email: lihaobin@wellsenn.com



咨询/合作/加群: wellsenn XR助理
电话/微信: 17302629715
Email: service@wellsenn.com

关于我们:

维深信息Wellsenn XR是VR/AR/MR产业垂直研究机构, 公司专注于对VR/AR/MR产业上游供应链和整机, 中游VR/AR/MR软件、下游VR/AR/MR内容以及应用场景的系统性跟踪和研究, 以定量分析为主定性分析为辅、通过自上而下和自下而上相结合的研究方法, 为VR/AR/MR从业者和投资者提供及时的、客观的、全面的、有前瞻性的数据分析、行业研究和咨询服务。

版权声明:

本报告分为免费版、付费版和会员版, 所有版权归属维深信息所有。对于公开免费版, 引用请注明数据来源为“维深信息wellsenn XR”, 对未注明来源的引用、盗用、篡改或其他侵犯维深信息著作的行为, 维深信息将保留追究法律责任的权利。对于付费版和会员版, 可以引用报告数据和内容, 请注明数据来源为“维深信息wellsenn XR”, 严禁整篇报告抄袭复制、恶意篡改、传播转发等侵权行为, 一经发现, 维深信息将按照复制转发的传播次数、受众人数追究相关机构和人员的法律责任以及损失赔偿。

免责声明:

本报告所采取的数据均来自合规渠道, 研究方法和分析逻辑基于维深信息的专业理解, 准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发布和流转, 在任何情况下, 本报告中的信息或者表述的观点均不构成对任何人和任何机构的投资建议。本报告的信息来源于公开的资料和数据库, 维深信息对该信息的准确性、完整性或者可靠性做尽可能的追求但不作任何保证。本报告所陈列的数据和资料、观点意见和推测预测仅反映报告发布时点维深信息的判断, 在不同时期, 维深信息可发出与本报告所载的资料、意见及推测不一致的报告。维深信息不保证本报告所含的信息在最新的状态, 同时, 维深信息对本报告所含信息可在不发出通知的情况下做出修改, 读者可自行关注和跟踪维深信息最新更新和修改。



公众号



交流群

Wellsenn